

【CNMO新闻】大家应该听说过可拆卸式的模块化手机

，这给手机带来了更多个性化配置，但是，你们知道芯片也可以DIY吗？据CNMO了解，近日，麻省理工学院¹的工程师已经朝向芯片模块化的愿景迈出了一步，他们采用了类似乐高的设计，设计出可堆叠、可重新配置的人工智能芯片。这种设计能够使得智能设备的半导体芯片始终保持最新状态，同时又能减少电子垃圾。相关成果已经发表在近期的《自然-电子学》杂志上。

高通骁龙芯片

新设计采用的是光传输信息，因此，该芯片可被重新配置，元件层也可被堆叠。在智能电子设备更新日益加快的时代，很多人换手机的速度也随之增加，其中，芯片的换代以及老化是导致这一现象最主要的原因之一，这对消费者的钱包以及环境来说并不友好。

如果上述工程师研发的乐高式芯片能够投入到量产，那将对手机产业产生革命性的颠覆。当前主流手机芯片

分别为：苹果A系列、高通骁龙系列、海思麒麟系列、三星Exynos系列以及联发科天玑系列，众多的芯片让消费者目不暇接。试想，在你的手机变卡后直接掏出当下最新款的芯片像更换手机卡一样换上，就能让你的爱机重获新生，那是多么的神奇

。

这一研发成果，对于手机领域无疑是革命性的，芯片模块化是否会正式投入到量产手机中呢，CNMO将与大家一起拭目以待。